Low Noise GaAsFET(CK24, CK34 Package) はんだ実装後のフラックスの洗浄に関して Flux Cleaning After Solder Mounting	KMR-CEF-0064	1/2
	2015年　11月　6日	
	中央電子工業株式会社 電子デバイス事業部 Chuo Denshi Kogyo Co., Ltd Electronic Devices Division	

Low Noise GaAsFET(CK24, CK34 Package)は、エポキシ樹脂によるキャップ封止パッケージであり、気密封止を有するものではありません。
Low Noise GaAsFET(CK24, CK34 Package) is a cap molding package by epoxy resin but not a hermetic sealing package.

本デバイスは実装後にフラックス洗浄を実施しますと、電気的特性の低下を招く恐れがありますので、洗浄は実施しないでください。
Do not conduct flux cleaning after mounting for it could cause degradation of electric characteristics.

本デバイスの実装に関しては、無洗浄フラックスのクリームはんだを使用ください。
Use non-cleaning flux solder paste in device mounting.

弊社の無洗浄フラックスの推奨条件を以下に示します。
Followings are recommended non-cleaning flux conditions.

1、 推奨無洗浄フラックス
Recommended non-cleaning flux

・超低残さフラックス(ULF-500VS, ULF-210R)
Super low residue flux(ULF-500VS, ULF-210R)

・低残さフラックス(CF-220V)
Low residue flux(CF-220V)

・失活性フラックス(AM-173)
Deactivation flux(AM-173)

・塩素含有量0.2wt%以下のフラックス
0.2wt% or less chlorine content flux

２、注意事項
Precaution

・フラックスの種類は、一般にロジン系と水溶性の２種類に大別されます。
Flux is generally divided into two types, rosin flux and aqueous flux.

・ロジン系フラックスは、その活性力の違いにより、以下の３タイプに分類されます。
Rosin flux is largely divided into three types, R, RMA, and RA, by order of activation.

○Rタイプ(Rosin base)：非活性ロジンフラックス、非腐食性。
R type(Rosin base): non-active rosin flux, non-corrosive

○RMAタイプ(Mildly Activated Rosin base)：弱活性ロジンフラックス、非腐食性。
Rタイプよりもはんだ付け性が優れている。
RMA type (Mildly Activated Rosin base): mildly activated rosin flux, non-corrosive.
Better solderability than R.

○RAタイプ(Activated Rosin base)：強活性ロジンフラックス。
RA type(Activated Rosin base) : Strongly activated rosin flux
R, RMAタイプよりもはんだ付け性が優れているが、腐食性が強くなっている。
Better solderabiliby than R, RMA but with strong corrosion behavior.

・水溶性のフラックスは、一般的に塩素含有量が多く半導体デバイスの信頼性に影響を及ぼす恐れがあります。
Aqueous flux is generally high chlorinated and it may cause degradation of a semiconductor device.

・ロジン系フラックスを使用した場合でもはんだ付け後の残さには多種の物質が含まれており、これらが高温・多湿時にパッケジリードやプリント配線板の導体部の腐食や絶縁低下などの現象を引き起こす場合があります。
Keep away from the environment of high temperature and high humidity even after using rosin flux for solder residue may cause corrosion or insulation degradation of package lead or print circuit board.

・はんだくず、不純物などにより絶縁劣化や特性劣化を起こす可能性がありますので、適切な実装基板評価を行い、不都合が起こらないことをご確認ください。
Dirt and stains tend to adhere and these may cause malfunctions. Therefore, take precautions to avoid this during cleaning.